

2013年度 第2四半期
決算説明会



(証券コード:6787)

2013年11月20日

注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績見通し等の計画・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの見通しは過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成した見通しです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は見通しと異なることがございます。

2013年度Q2 実績

1

2013年度Q2 実績

2

2013年度 見通し

3

中期経営計画

2013年度上期 決算のポイント

連結実績

- 売上高 37,724百万円 前年同期比 +28.0%
- 営業利益 691百万円 前年同期比 +866.1%

プラス要因(前年同期比)

- アジア系および中華系スマホ向け基板の好調な受注
(中国武漢・越南)
- 車載向け基板の堅調な伸長(中国広州・武漢)

マイナス要因(前年同期比)

- 越南火災事故の影響

2013年度上期 主要経営指標(連結)

(百万円)		2012年度2Q	2013年度2Q	
		実績	実績	前年比
売上高		29,473	37,724	28.0%
営業利益		71	691	866.1%
営業利益率		0.2%	1.8%	
経常利益		-1,826	982	—
経常利益率		-6.2%	2.6%	
当期純利益		-2,747	235	—
当期純利益率		-9.3%	0.6%	
1株当たり当期純利益		-146.34	12.56	
換算レート	JPY/USD	78.96	98.62	
	RMB/USD	6.33	6.18	

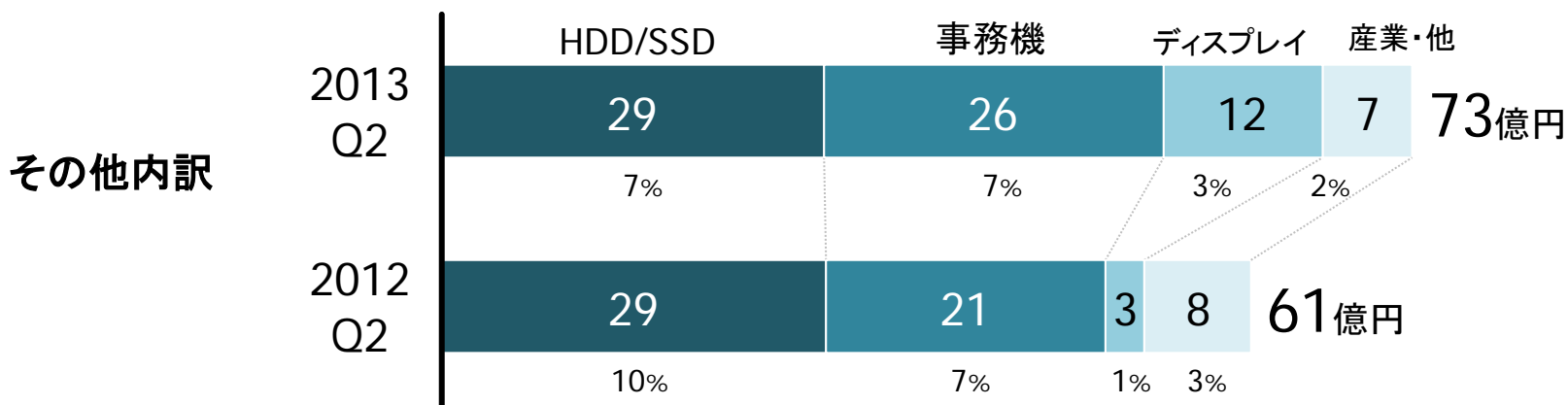
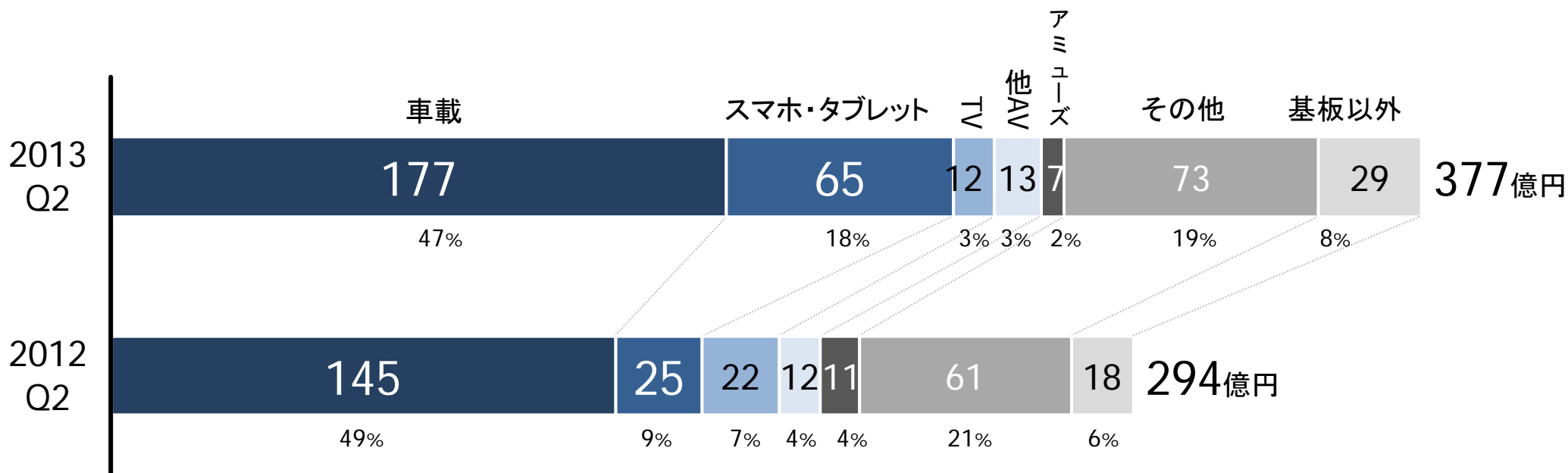
2013年度上期 海外工場実績

- 広州工場: 車載の堅調な伸びによる緩やかな増収
- 武漢工場: 中華系スマホ・車載の堅調な受注による大幅な増収、黒字化
- 越南工場: アジア系スマホを中心とする受注増による大幅な増収

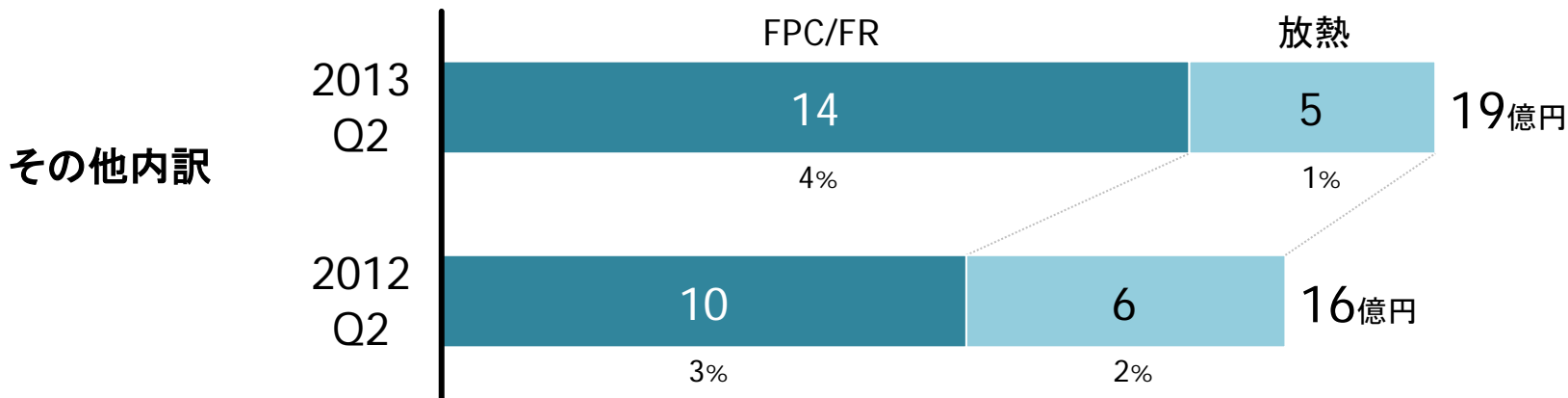
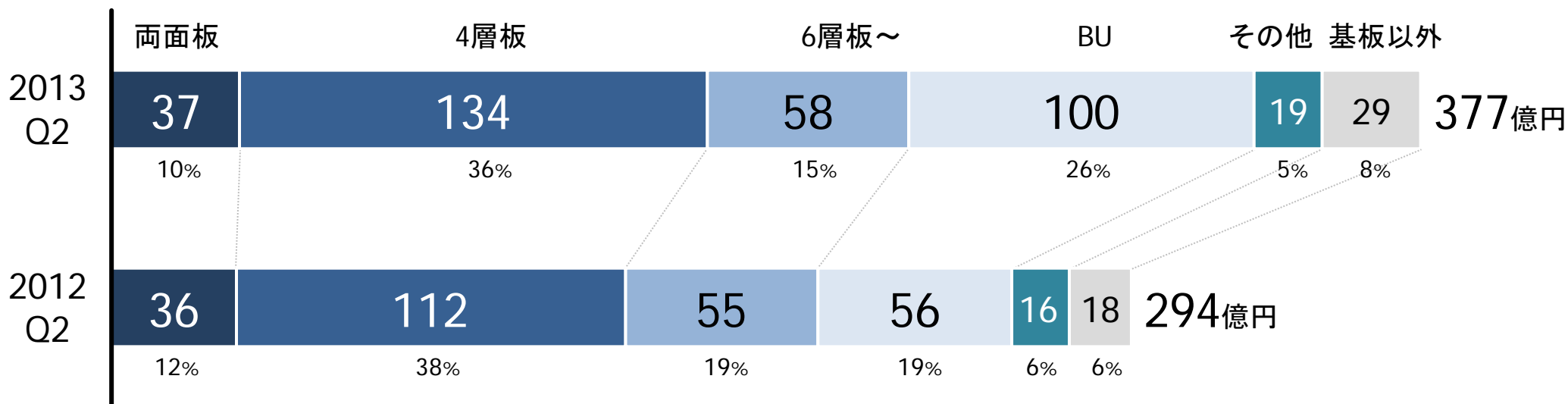
(百万円)

		2012年度Q2	2013年度Q2	前年比
広州	売上高	14,362	15,772	9.8%
	営業利益	1,050	941	-10.4%
	営業利益率	7.3%	6.0%	
武漢	売上高	8,476	12,588	48.5%
	営業利益	-888	57	-
	営業利益率	-10.5%	0.5%	
越南	売上高	820	3,038	270.5%
	営業利益	-829	-347	-
	営業利益率	-101.1%	-11.4%	

2013年度上期 市場別実績



2013年度上期 品目別実績



主要PCBメーカーでの弊社の位置づけ

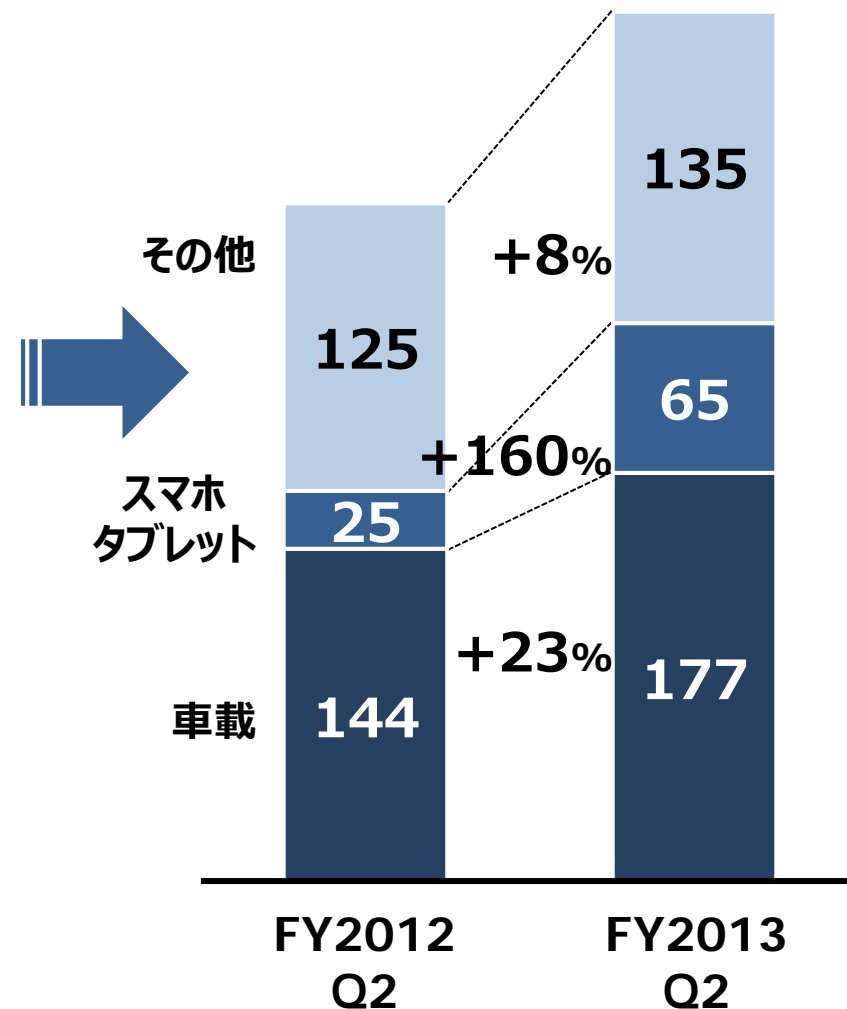
国内主要PCBメーカー売上実績

単位:百万円

社名	FY2012Q2 売上高	FY2013Q2 売上高	増減率
イビデン	83,814	75,933	-9.4%
メイコー	29,473	37,724	28.0%
日本CMK	38,675	34,658	-10.4%
キョウデン	18,845	19,453	3.2%
シライ電子	11,518	11,998	4.2%
エルナー	9,887	9,318	-5.8%

※エルナーは4-9月(12月期)の数値です。

当社商品別売上実績(Q2対比)



越南火災事故について

発生場所・日時

- 日時: 平成25年9月2日 20時30分頃(ベトナム時間)
- 場所: PCB工場1階 めっき工程

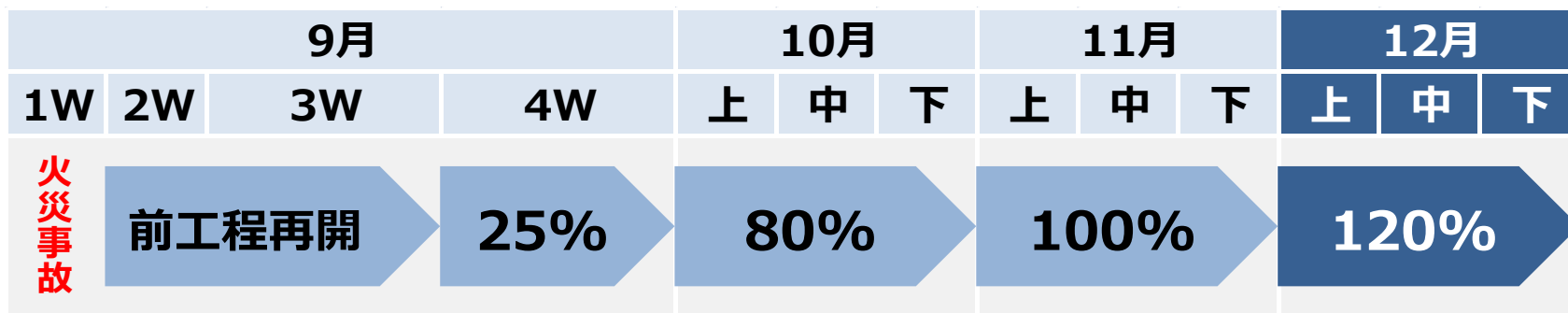
被害状況

- めっき工程(2ライン)焼損、隣接工程の一部煙損

業績への影響額

- 営業損益 9月: ▲6.2億円 3Q: ▲2億円 計▲8.2億円
- 物的損害額は精査中(保険金による補てんの予定)

稼働状況



2013年度 見通し

1

2013年度Q2 実績

2

2013年度 見通し

3

中期経営計画

2013年度 連結決算見通し

(百万円)	2012年度	2013年度	
	実績	計画	前年比
売上高	60,709	79,000	30.1%
営業利益	-605	3,000	—
営業利益率	-1.0%	3.8%	
経常利益	-386	2,800	—
経常利益率	-0.6%	3.5%	
当期純利益	-1,567	1,400	—
当期純利益率	-2.6%	1.8%	
1株当たり当期純利益	-83.52	74.57	
換算レート	JPY/USD	83.31	98.00
	RMB/USD	6.30	6.15

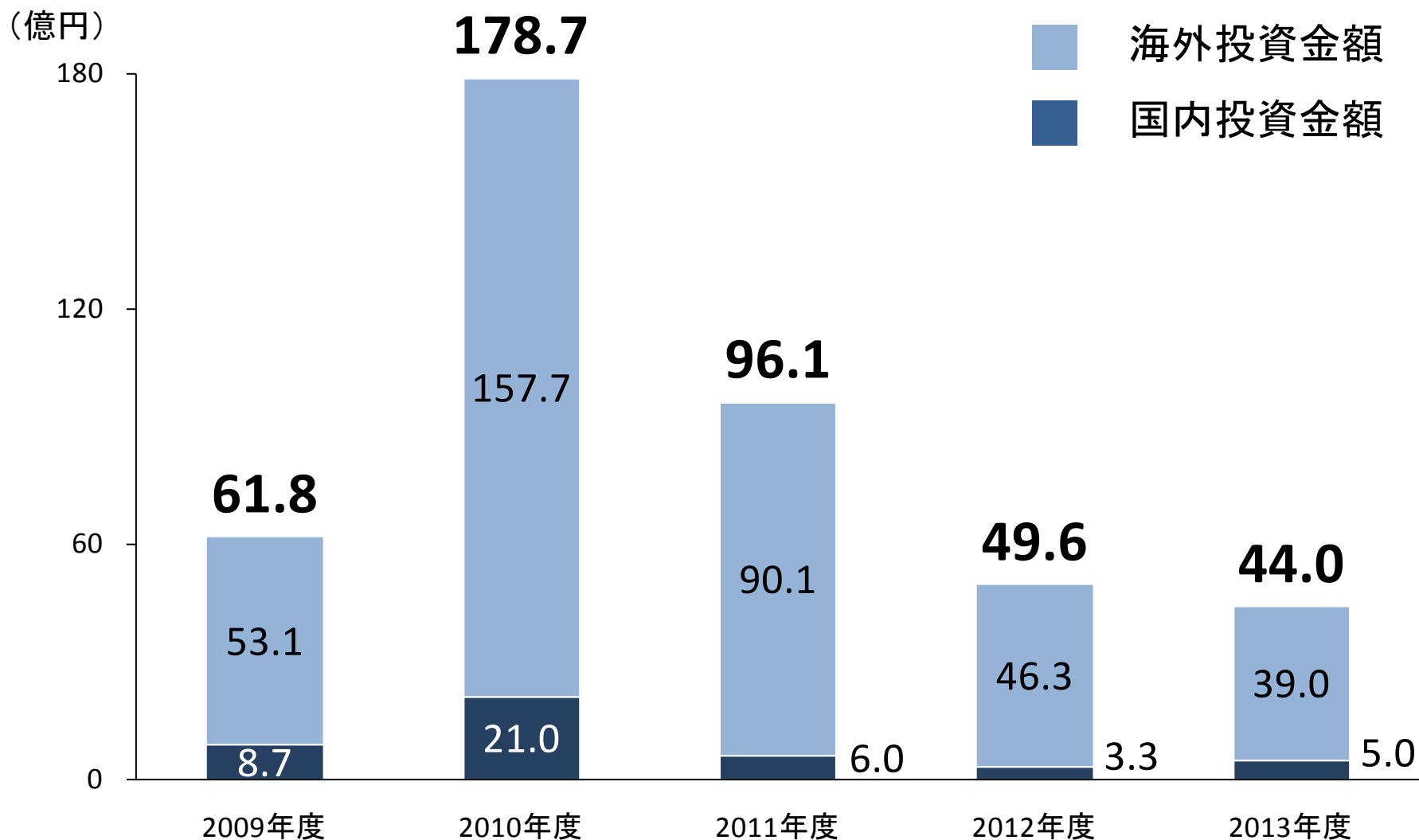
2013年度 海外工場見通し

- 広州工場: 上期に続き車載の堅調な伸びによる緩やかな増収
- 武漢工場: 中華系スマホ基板、車載基板、SSDの増産による大幅増収
- 越南工場: BU基板のさらなる増産により黒字化達成見込み

(百万円)

		2012年度	2013年度	前年比
広州	売上高	27,661	29,500	6.6%
	営業利益	1,570	1,500	-4.5%
	営業利益率	5.7%	5.1%	
武漢	売上高	17,665	25,800	46.1%
	営業利益	-2,638	640	-
	営業利益率	-14.9%	2.5%	
越南	売上高	3,390	8,100	138.9%
	営業利益	-1,461	150	-
	営業利益率	-43.1%	1.9%	

2013年度 設備投資見通し



中期経営計画

1

2013年度Q2 実績

2

2013年度 見通し

3

中期経営計画

主要経営指標

(億円)		2012年度	2013年度	2014年度	2015年度
売上高		607	790	850	920
営業利益		-6	30	49	63
営業利益率		-1.0%	3.8%	5.8%	6.8%
減価償却		53	61	63	63
設備投資		43	44	55	55
換算レート	JPY/USD	83.31	98.00		
	RMB/USD	6.30	6.15		

中期基本戦略

生産戦略

- 車載向け基板の品質とキャパシティNo.1に向けた生産体制の確立
- スマホ向け基板の歩留まりのさらなる向上
- 生産性向上のための合理化投資

販売戦略

- 車載市場No.1に向けた拡販体制の強化
- アジア系および中華系スマホメーカーへの拡販

技術戦略

- 新規開発製品の商品化
- 独シュバイツァー社との技術提携によるシナジー効果

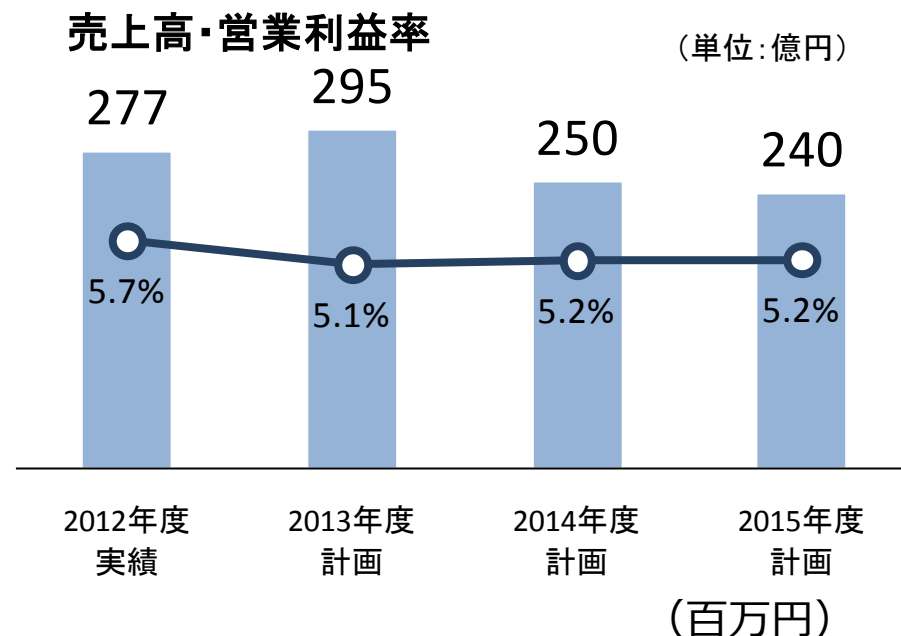
財務戦略

- 財務バランスの改善

生産戦略－広州工場重点施策

重点施策

1. 品質向上のための設備投資
2. 生産性改善のための合理化投資

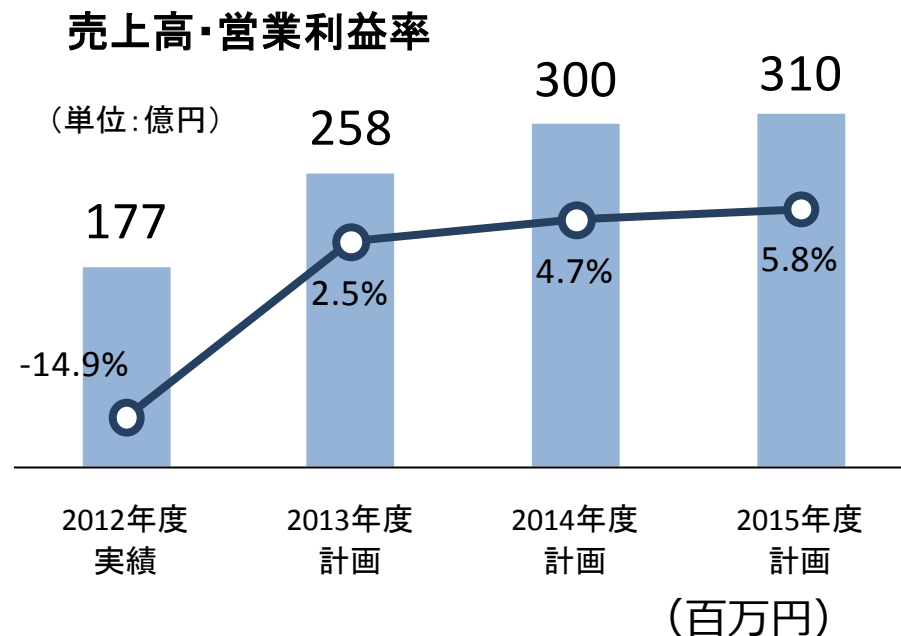


	2012年度 実績	2013年度 計画	2014年度 計画	2015年度 計画
売上高	27,661	29,500	25,000	24,000
営業利益	1,571	1,500	1,300	1,250
営業利益率	5.7%	5.1%	5.2%	5.2%

生産戦略－武漢工場重点施策

重点施策

1. 第一工場：車載・HDD/SSD向け
基板増産対応
2. 第二工場：中華系・日系・韓国向け
BU基板増産対応
3. 車載向け基板に対する品質向上



	2012年度 実績	2013年度 計画	2014年度 計画	2015年度 計画
売上高	17,665	25,800	30,000	31,000
うち半製品売上	2,000	1,100	500	300
営業利益	-2,638	640	1,400	1,800
営業利益率	-14.9%	2.5%	4.7%	5.8%

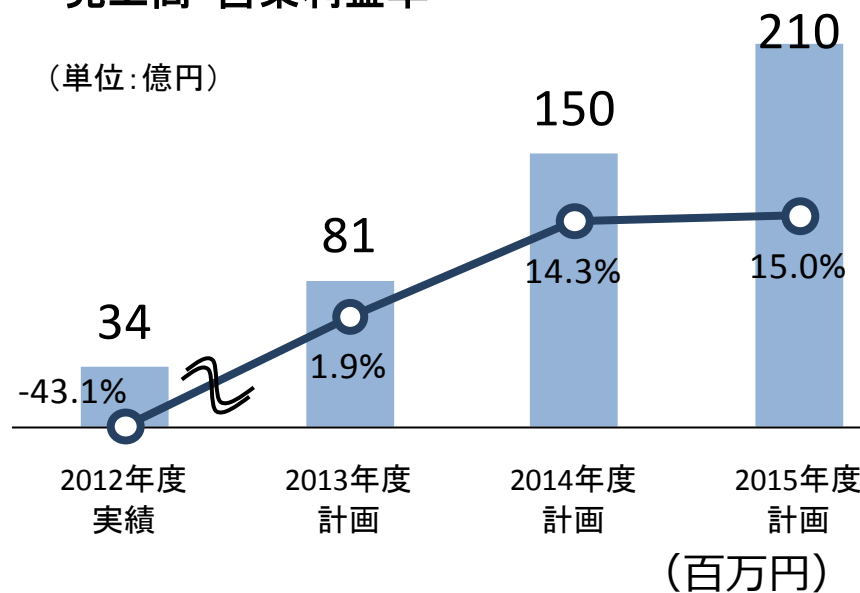
生産戦略－越南工場重点施策

重点施策

1. スマホ向けBU基板の量産品短納期供給
2. 車載向け基板、独シュバイツァー社との合併ラインの2014年度立ち上げ
3. 新規技術製品の投資

売上高・営業利益率

(単位: 億円)

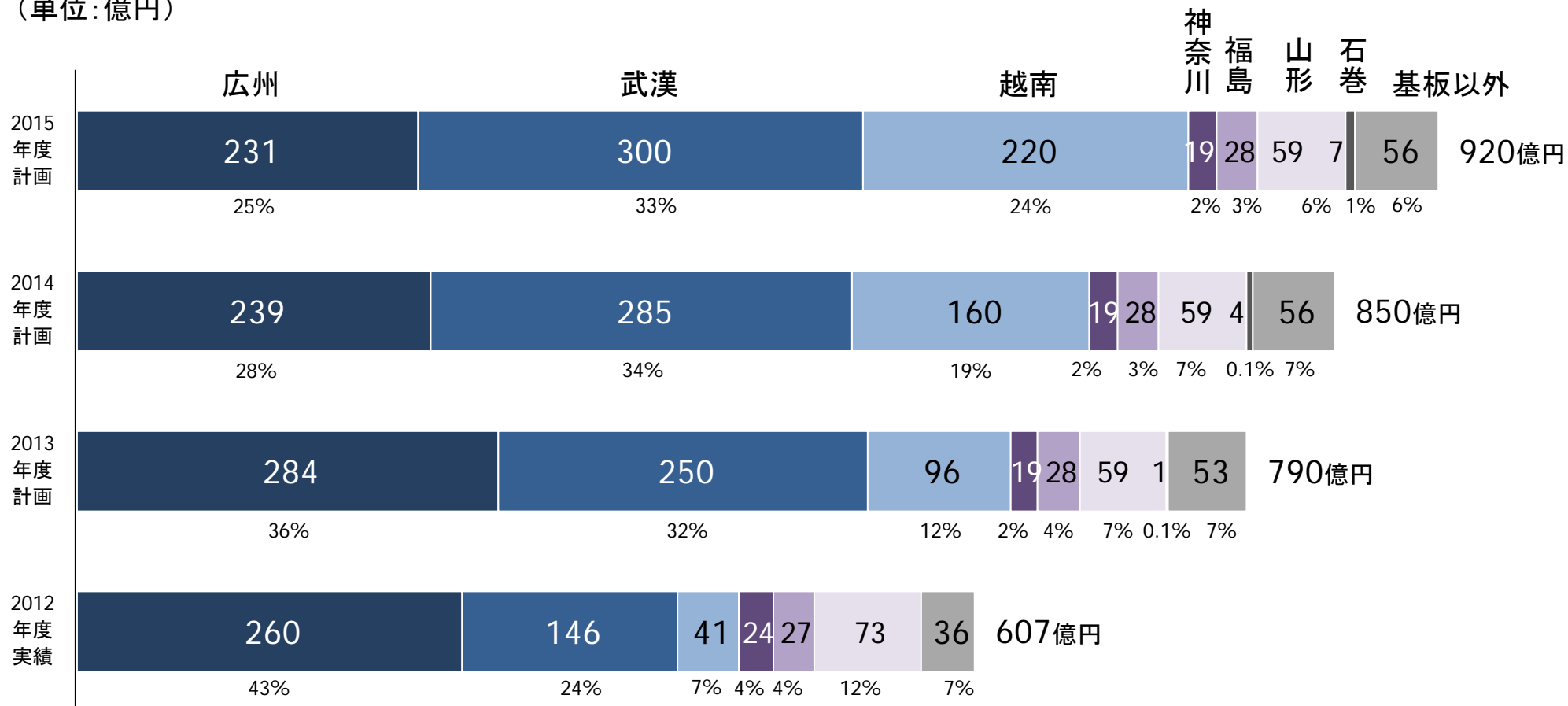


	2012年度 実績	2013年度 計画	2014年度 計画	2015年度 計画
売上高	3,390	8,100	15,000	21,000
営業利益	-1,462	150	2,150	3,150
営業利益率	-43.1%	1.9%	14.3%	15.0%

(注) EMSは含まれていません。

生産戦略－基板工場別売上計画

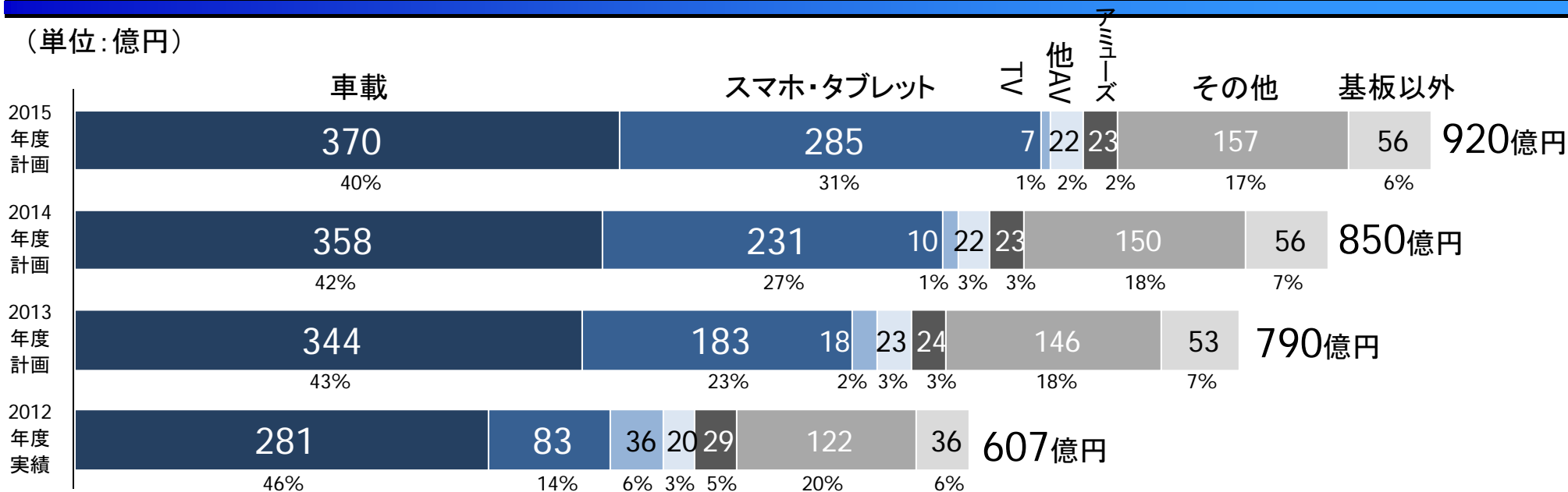
(単位:億円)



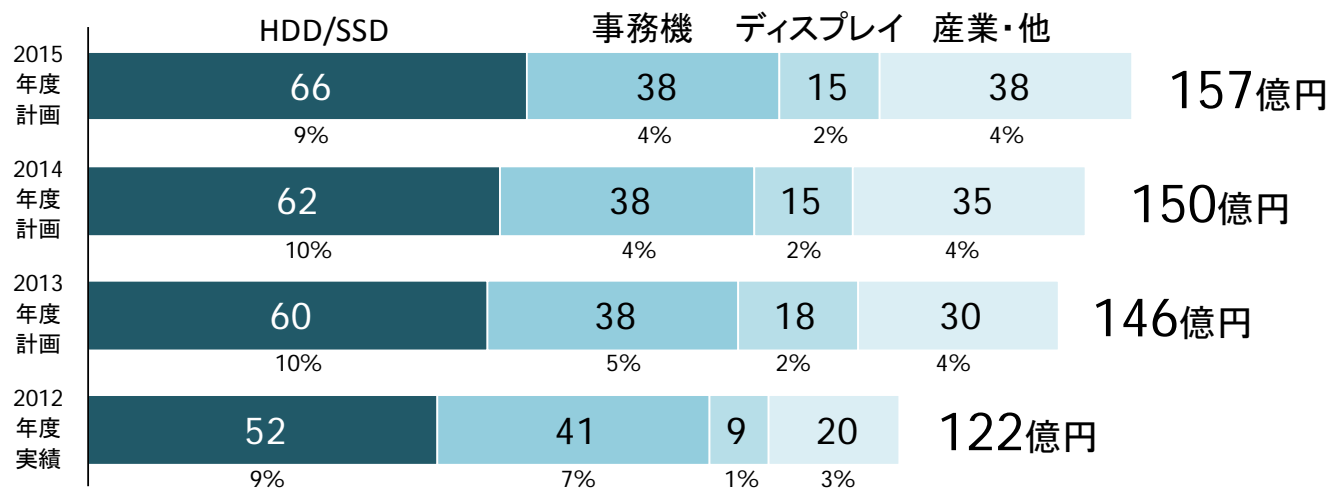
(注)各工場数値は基板事業のみの売上であり、設計、ツール、半製品は含みません。

販売戦略－基板市場別売上計画

(単位:億円)

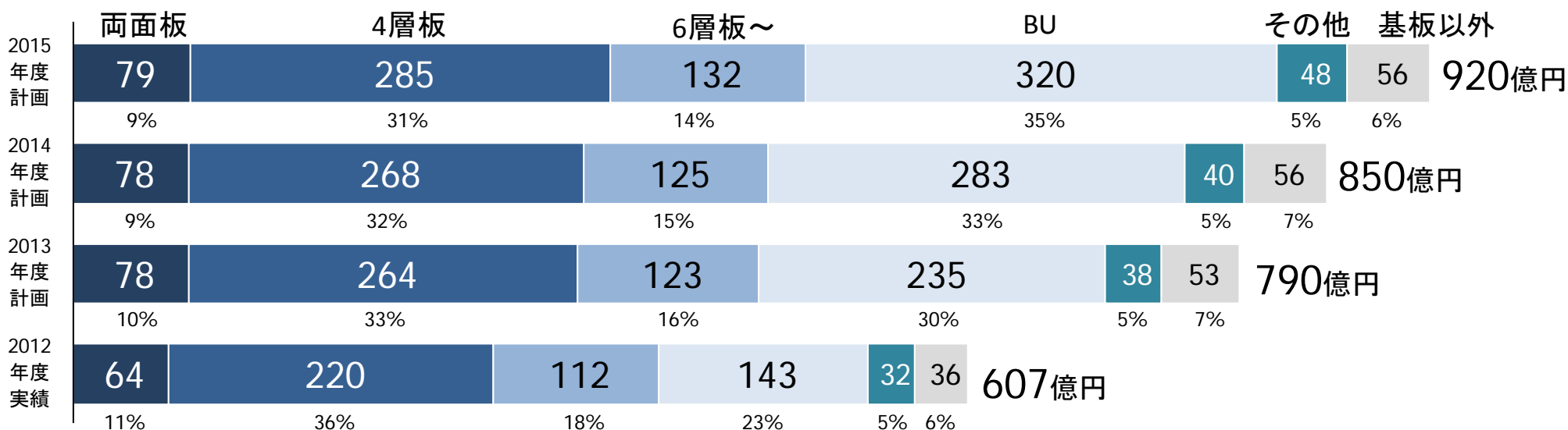


その他内訳

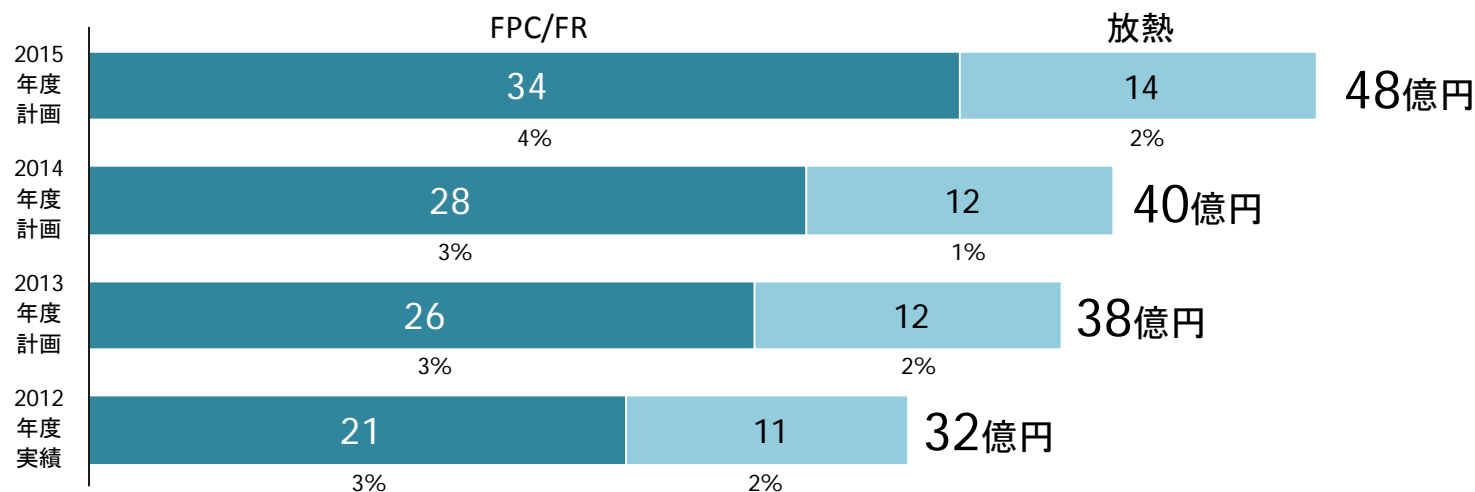


販売戦略－基板品目別売上計画

(単位:億円)

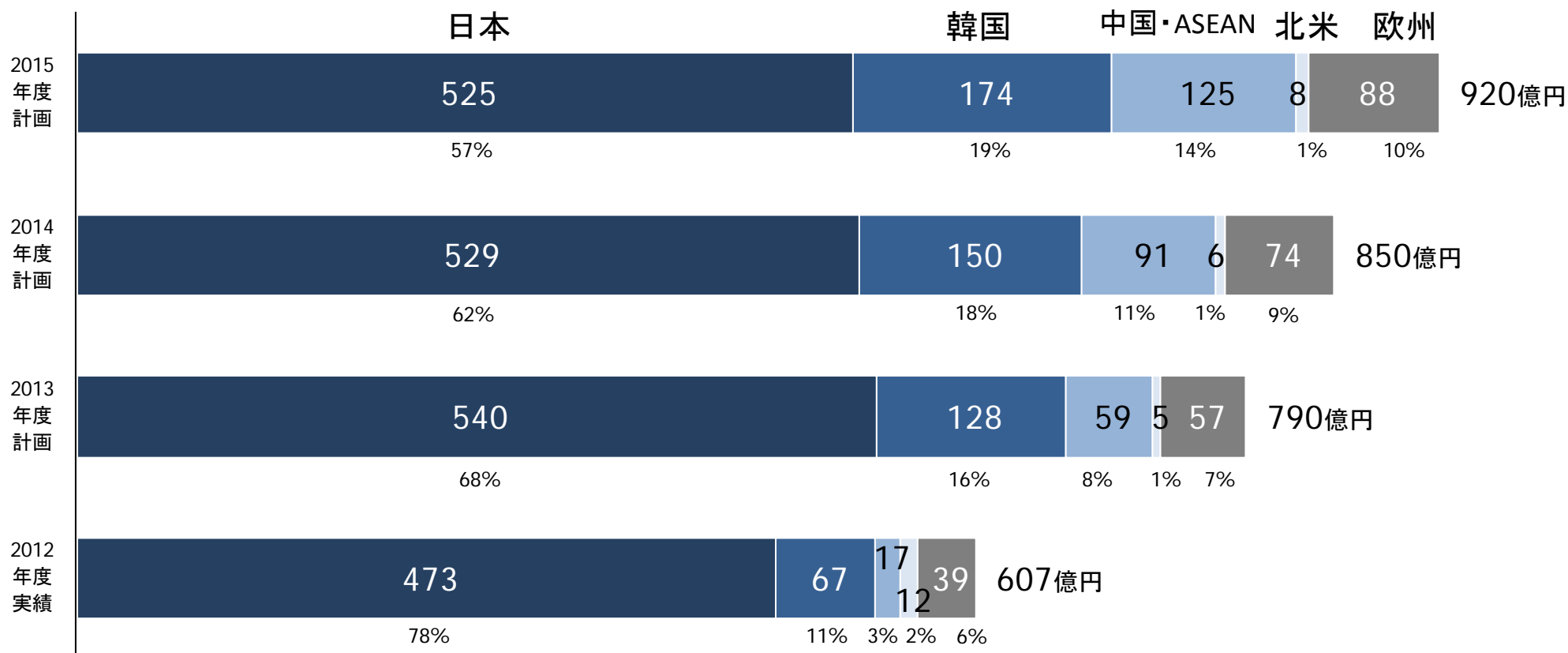


その他内訳



販売戦略－顧客国籍別売上計画

(単位:億円)

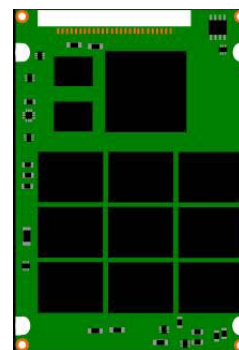


技術戦略－新商品ラインナップ(1/2)

部品内蔵基板

- 受動部品内蔵によるメリット
 - － SSDメモリーチップの配置面積拡大によりメモリー容量が増大
 - － 電源コンデンサへの配線長短縮により電気特性が向上
- 部品内蔵基板の特性
 - － 銅めっき接続工法により高信頼性・高密度配線を実現

【SSD搭載例(断面写真)】



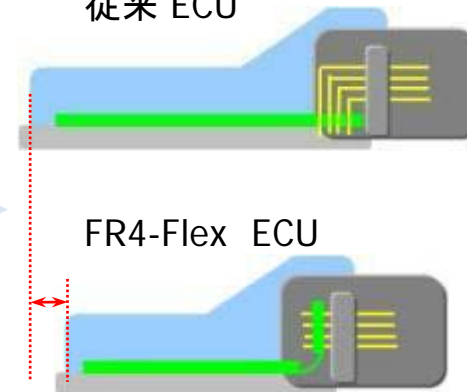
FR4-Flex

- プロセスの簡素化による低コストの実現
- 従来リジッドと同様の信頼性を維持
- ポリイミドレスリジッド-フレックス基板を開発
- 欧州車載メーカーで採用済み

【FR4-Flex 使用例】

PCBを90° 折り曲げることによりECUの小型化が可能

従来 ECU

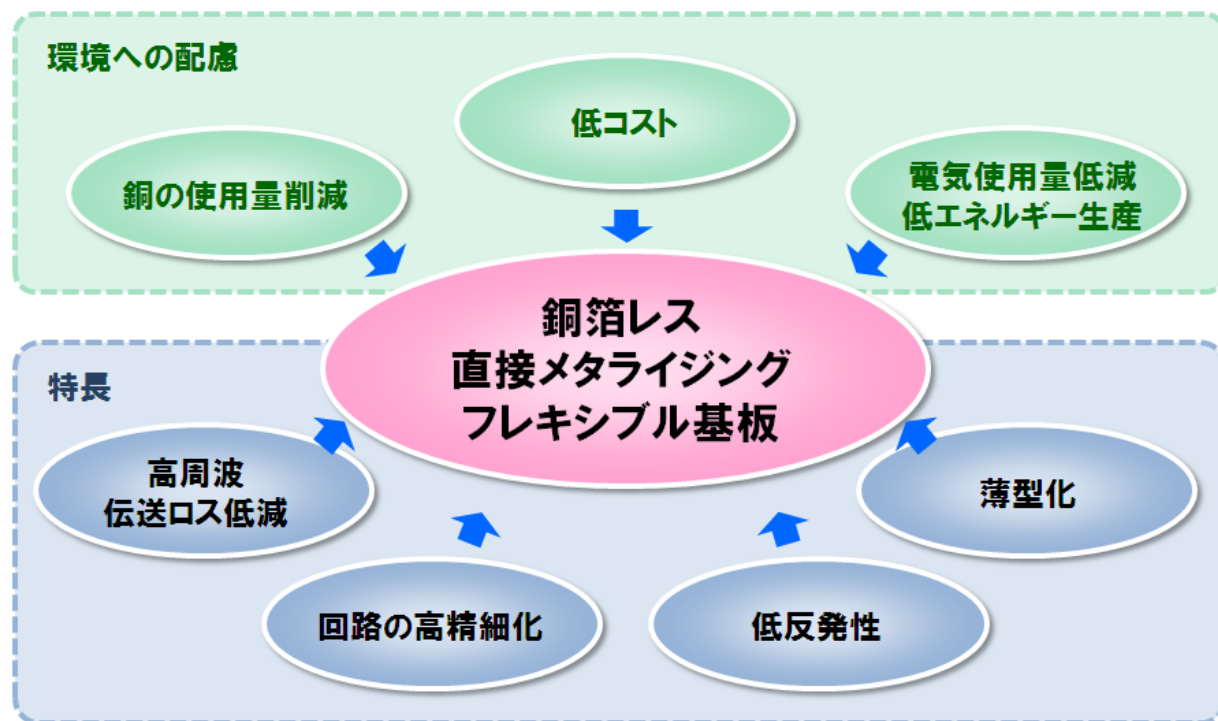


FR4-Flex ECU

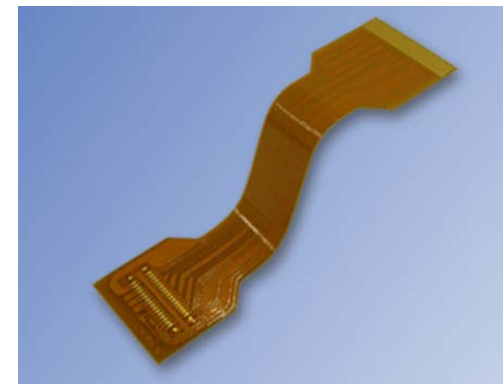
技術戦略－新商品ラインナップ(2/2)

新工法FPC(MDiM)

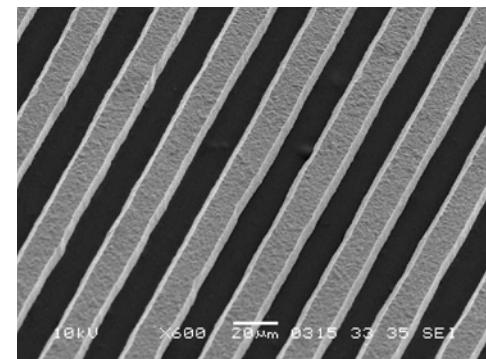
- 分子接合技術を用いた新FPC基板
- 厚みを2/3まで薄くすることに成功
- 回路の高精密化、高周波・伝送ロス低減を実現
- 更に銅や必要電気料をカットし、大幅なコストダウンに成功



【MDiM外観】



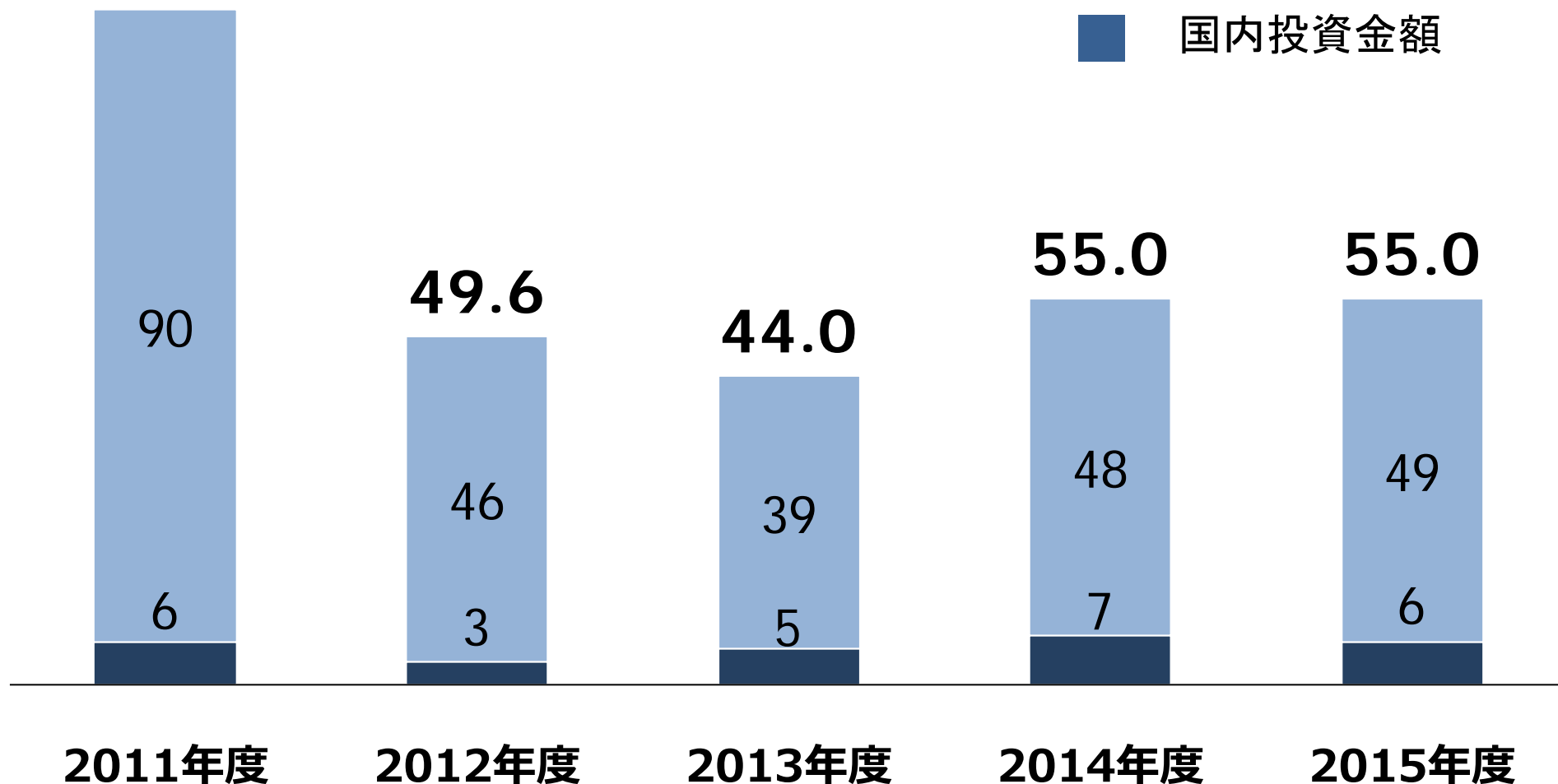
【回路の高精密細化】



設備投資計画

(億円) **96.1**

■ 海外投資金額
■ 国内投資金額



車載ECU市場の見通し

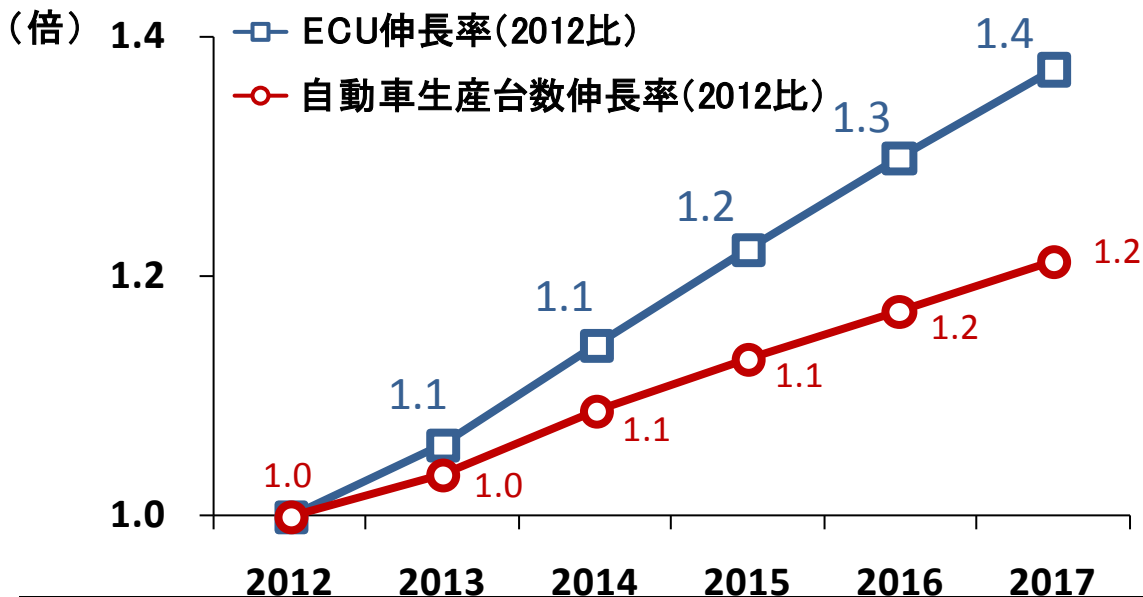
■ 車載ECUの販売台数と自動車生産台数の予測

(単位: ECU販売数量: 1,000個 自動車生産台数: 1,000台)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ECU販売数量	1,503,670	1,593,240	1,718,615	1,839,290	1,954,220	2,062,690
伸長率(2012比)	1.00	1.06	1.14	1.22	1.30	1.37
自動車生産台数	84,110	86,985	91,500	95,135	98,510	101,970
伸長率(2012比)	1.00	1.03	1.09	1.13	1.17	1.21

生産台数伸長率 < ECU販売数量伸長率

■ 車載ECUの販売台数と自動車生産台数の伸長率比較

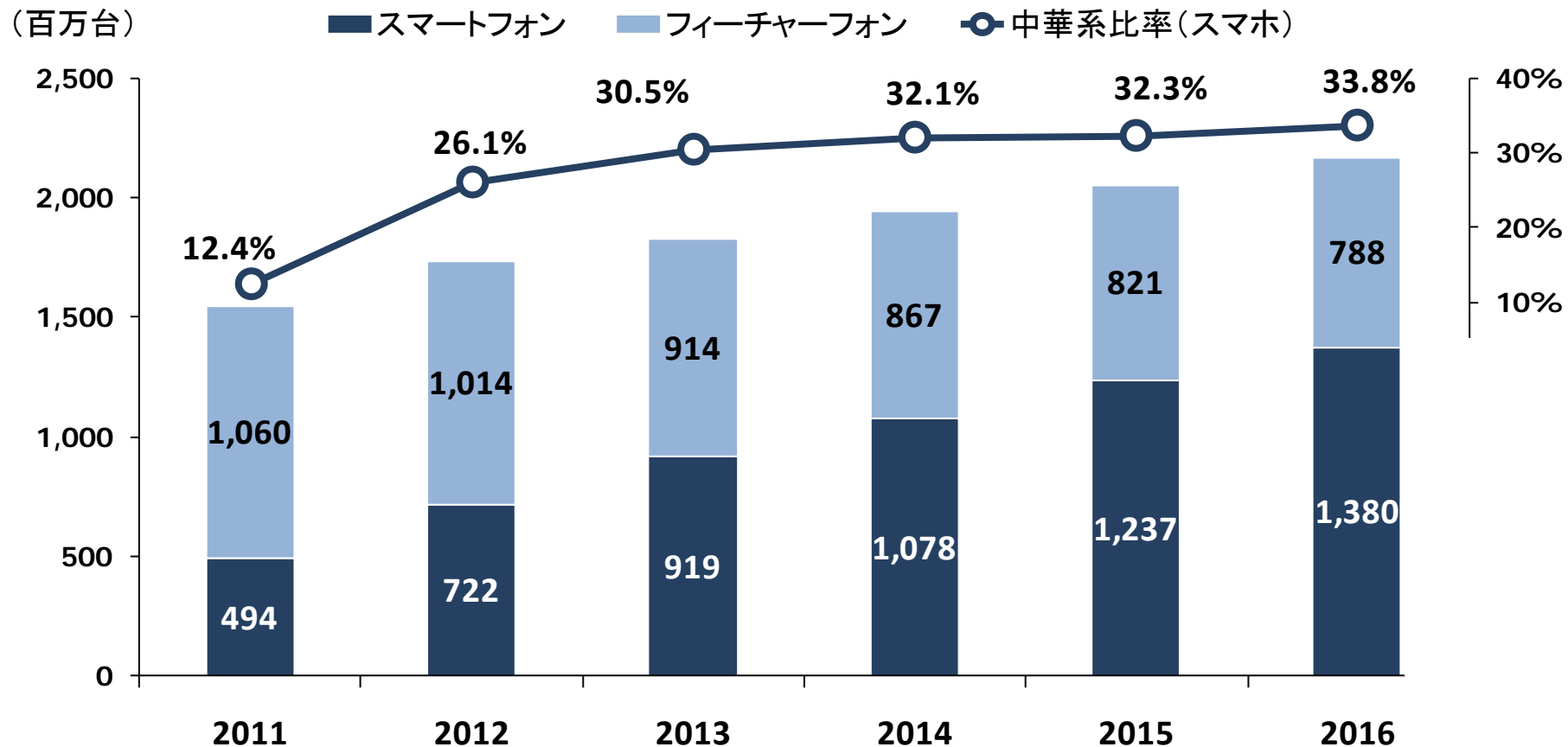


**車載の電装化に伴う
PCB需要増が見込まれます。**

出典: 富士キメラ総研 2013車載ECU関連市場の現状と将来展望

携帯電話・スマートフォン市場の見通し

スマートフォン・フィーチャーフォンの世界出荷台数予測



出典: IDC(2013/3)



<http://www.meiko-elec.com/>